

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 20 年 1 月 17 日 (2008.1.17)

【公開番号】特開 2007-227341 (P2007-227341A)

【公開日】平成 19 年 9 月 6 日 (2007.9.6)

【年通号数】公開・登録公報 2007-034

【出願番号】特願 2006-205935 (P2006-205935)

【国際特許分類】

H 0 1 R 13/24 (2006.01)

H 0 1 R 33/76 (2006.01)

H 0 1 R 43/00 (2006.01)

G 0 1 R 1/073 (2006.01)

G 0 1 R 1/067 (2006.01)

G 0 1 R 31/26 (2006.01)

【F I】

H 0 1 R 13/24

H 0 1 R 33/76 5 0 5 Z

H 0 1 R 43/00 B

G 0 1 R 1/073 B

G 0 1 R 1/067 C

G 0 1 R 31/26 J

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 11 月 21 日 (2007.11.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

両面に複数のスパイラル接触子が設けられた中継ボードの上にガイド部材が対向配置され、前記ガイド部材の上に複数の外部接触子を有する電子部品が設置される接続ボードにおいて、

前記ガイド部材は、金属製の本体部と、本体部の周囲に形成された樹脂製のフレームとを有し、前記フレームが前記中継ボードに支持されており、

前記本体部に複数の小孔が形成され、それぞれの前記外部接触子が、前記小孔に挿入されて前記スパイラル接触子に接触可能とされていることを特徴とする接続ボード。

【請求項 2】

前記本体部の、少なくとも 2 以上の隅部に位置決め用の小孔が、前記複数の小孔とともに開孔しており、前記位置決め用の小孔の直径が、その他複数の小孔の直径よりも小さい請求項 1 記載の接続ボード。

【請求項 3】

複数のスパイラル接触子を有する中継ボードの上に設置されて、電子部品に設けられた複数の外部接触子を前記スパイラル接触子と接続させるためのガイド部材を製造する方法において、

(a) 基板の表面にレジスト層を形成する工程と、

(b) 前記レジスト層に本体部形状をパターン形成する工程と、

(c) パターン形成された前記本体部形状内に金属製の本体部を形成する工程と、

(d) 前記レジスト層を除去する工程と、
(e) 前記本体部を絶縁コーティングする工程と、
(f) 金型内に前記本体部をセットする工程と、
(g) 前記金型に溶融樹脂を流し込む工程と、
(h) 前記溶融樹脂を固化させて、前記本体部の周囲に前記フレームを一体的に形成する工程と、
を有することを特徴とするガイド部材の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】削除

【補正の内容】